

证券代码：605358

证券简称：立昂微

杭州立昂微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	<div><div><div>●特定对象调研</div><div>□媒体采访</div><div>□现场参观</div><div>□其他</div></div><div><div>□分析师会议</div><div>□新闻发布会</div><div>□电话会议</div></div></div>
参与单位名称	中邮证券、富国基金等 3 人
时间	2025 年 7 月 23 日 15：00
地点	线上交流
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、财务总监、董事会秘书：吴能云
投资者关系活动记录	<p>公司围绕 2025 年半年度业绩预告已披露的半年度经营情况进行了说明，主要说明及投资者交流的问题回复内容如下：</p> <p>1.公司 8 英寸、12 英寸外延片的产能利用率如何？</p> <p>答：公司重掺外延片具有较强竞争力，是公司的特色产品，其中 6-8 英寸外延片产品自年初以来订单饱满，产能利用率保持在较高水平；12 寸外延片产品同样订单饱满，出货量同比、环比均有增长。12 英寸硅片总出货量下半年有望继续提高。</p> <p>2.公司 2025 半年度计提了减值，主要原因是什么？</p> <p>答：根据《企业会计准则》和公司相关政策，公司的存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货可变现净值，是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。因公司衢州、嘉兴 12 英寸硅片工厂仍处于亏损状态，基于上述政策计提了相应减值。</p> <p>3.公司化合物半导体射频芯片出货量出现下降，主要原因是什么？</p> <p>答：化合物半导体射频芯片的出货量同比环比下降的原因主要是与手机相关的 HBT 产品订单下滑，首先，一季度处于手机新品研发阶段，相应的元器件处于更新换代阶</p>

	<p>段：其次，目前手机 HBT 芯片价格较低，公司基于对盈利的考虑进行了产品结构的调整，减少低价手机客户 HBT 订单，转向更高技术含量的二维可寻址 VCSEL 芯片及低轨卫星、航空航天、机器人等领域的高价值产品，且高价值产品保持了不错的增速。</p> <p>4.目前 VCSEL 产品的进展情况如何？</p> <p>答：立昂东芯开发的二维可寻址 VCSEL 工艺技术，目前是行业内首家、中国大陆独家量产二维可寻址激光雷达 VCSEL 芯片的制造厂商，产品终端应用于车载智能驾驶的补盲激光雷达以及人形机器人、扫地机器人等场景，市场应用处于爆发元年。VCSEL 产品目前订单饱满，出货量大幅增长。</p>
资料清单 (如有)	无